

EINLADUNG

21. EUROPÄISCHES ELEKTRONIKTECHNOLOGIE-KOLLEG

Colonia de Sant Jordi, Mallorca (E) – Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
21. März bis 25. März 2018

Surface Mount Technology – State of the Art Fertigung heute

Kaum eine zweite industrielle Fertigung ist in ihrer Komplexität und Variantenvielfalt mit der Produktion von elektronischen Baugruppen zu vergleichen. Ursächlich dafür sind die Elektronikprodukte selbst, die zu einer der wesentlichen Triebkräfte kultureller gesellschaftlicher Entwicklung weltweit geworden sind und die alle Lebensbereiche moderner Menschen durchdringen. Auf den Surface-Mount-Linien werden heute kleinste Ear-Sets ebenso gefertigt, wie Smart Things oder gewichtige Power Elektronik. Fast täglich kommen neue Bauelemente und Materialien auf den Markt, die in einem Aufbau- und Verbindungsprozess zu Produkten gefügt werden.

Das 21. EE-Kolleg stellt die hierfür notwendigen Prozesse in den Mittelpunkt seiner Vorträge und Diskussion. Experten bringen ihr Know-how „an die Oberfläche“ und berichten über Wege, Methoden und Bottlenecks aus ihrer täglichen SMT-Praxis.

Das angenehme Ambiente des Tagungsortes eröffnet Ihnen die Möglichkeit zum ausgedehnten Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis sowie mit den Referenten und Geschäftspartnern/Veranstaltern des Kollegs, den Firmen ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG, ASYS Group Asys Automatisierungssysteme GmbH, Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Christian Koenen GmbH, kolb Cleaning Technology GmbH und Rehm Thermal Systems GmbH.

Das inhaltliche Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Produktion sowie an Mitarbeiter der Arbeitsvorbereitung, der Technologie, der Entwicklung, der Konstruktion und des Qualitätsmanagements.
Die Konferenzsprache ist Deutsch.

Die Veranstalter laden Sie herzlich zum 21. Europäischen Elektroniktechnologie-Kolleg ein.

Im Auftrag der Veranstalter
TBB Franziska Bell

Veranstalter:

ASM Assembly Systems, ASYS Group, Balver Zinn, Christian Koenen,
kolb Cleaning Technology, Rehm Thermal Systems

Termin:

21. bis 25. März 2018

Organisation:

TBB Technologie Beratung Bell

Information und Anmeldung bei:

TBB Technologie Beratung Bell
Dipl.-Krist. Franziska Bell
Hadlichstr. 26 | D-13187 Berlin
Telefon: (030) 4810363
E-Mail: franziskabell@t-b-bell.de

Veranstaltungsort:

Hotel: Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
Camino de los Estanques s/n
E-07638 Colonia de Sant Jordi (Baleares)

PROGRAMM

21. EUROPÄISCHES ELEKTRONIKTECHNOLOGIE-KOLLEG

Colonia de Sant Jordi, Mallorca (E) – Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
21. März bis 25. März 2018

Surface Mount Technology – State of the Art Fertigung heute

Moderation: Dr. Hans Bell, Rehm Thermal Systems GmbH

Donnerstag, 22. März 2018

08:15	Einschreiben der Teilnehmer
09:00	Eröffnung und Einführung Dr. Hans Bell, Rehm Thermal Systems GmbH, Blaubeuren
09:30	Leiterplattenoberflächen Christian Ranzinger, CONTAG AG, Berlin
10:15	Kaffeepause
10:45	Aufbau- und Verbindungstechnik mit flexiblen Leiterplatten Peter Fischer, enmech GmbH, Wuppertal
11:30	Ein kleiner Punkt auf der Leiterplatte – ein Pluspunkt für die BG, SMD Kleben Karsten Dierker, Tonfunk GmbH Ermsleben, Falkenstein/Harz
12:15	Lunch
13:15	AOI in der Fertigung Prof. Dr. Christian Faber, Hochschule Landshut, Sensorik und Bildverarbeitung, Landshut
14:00	Kaffeepause
14:30	Innerbetriebliche Logistik in der SMT – Industrie 4.0 August Huber, DRÄXLMAIER Group EKB Elektro-u. Kunststofftechnik GmbH, Braunau (A)
15:15	SMD heute und morgen - ist Miniaturisierung die einzige Herausforderung? Thomas Mückl, Zollner Elektronik AG, Zandt
16:00	Diskussion
16:15	Ende

Freitag, 23. März 2018

09:00	Anforderung des Produkts an die Lotpasten-applikation Michael Matthes, WITTENSTEIN cyber motor GmbH, Igersheim
09:45	Lotpasten Josef Steuer, Neways Neunkirchen GmbH, Neunkirchen
10:30	Kaffeepause
11:00	Lotpastendruck aus Sicht des Bedieners – aus Fehlern lernen Ines Brune-Krok, Krüger & Gothe GmbH, Staßfurt
11:45	Wellenlöten Dr. Vinzenz Bissig, Thermission SA, Thun (CH)
12:30	Lunch
13:30	Einfluss des SMT Prozesses auf die Endeigenschaften von Geräten Dietmar Birgel, Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg
14:15	Kaffeepause
14:45	Migration und Korrosion bei elektronischen Baugruppen Günter Grossmann, EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf (CH)
15:45	Diskussion + Schlusswort
16:00	voraussichtliches Ende

Samstag, 24. März 2018

10:00	Ergänzende Begleitveranstaltung nach Wahl
-------	---



ANMELDUNG an TBB (franziskabell@t-b-bell.de | online unter: www.ee-kolleg.com)

21. EUROPÄISCHES ELEKTRONIKTECHNOLOGIE-KOLLEG

Colonia de Sant Jordi, Mallorca (E) – Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
21. März bis 25. März 2018

Surface Mount Technology – State of the Art Fertigung heute

Bitte in Druckschrift ausfüllen und **persönlich** unterschreiben!

Name: _____

Firma: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Gewünschter Abflugort *) (Hinflug 21.03.2018, Rückflug 25.03.2018):

Stuttgart München Nürnberg Hamburg Frankfurt

anderer Abflugort: _____

*) Die Verfügbarkeit der Flüge vom jeweiligen Abflugort ist abhängig vom Zeitpunkt Ihrer Anmeldung. Sollte kein Gruppenflug für Sie zur Verfügung stehen, werden eventuell entstehende Mehrkosten nach Abstimmung mit Ihnen zusätzlich in Rechnung gestellt. **Namensänderungen sind bei Flügen nicht möglich.**

Die Einladung erreichte mich über die Firma:

Die Teilnahmegebühr beträgt je Teilnehmer 1350,00 Euro zzgl. MwSt..

Beachten Sie bitte die Teilnahmebedingungen.

Hiermit erkläre ich, dass ich die „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ anerkenne, und melde mich zum 21. Europäischen Elektroniktechnologie-Kolleg vom 21. bis 25. März 2018 an:

Ort, Datum

Persönliche Unterschrift

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

21. EUROPÄISCHES ELEKTRIKTECHNOLOGIE-KOLLEG

Colonia de Sant Jordi, Mallorca (E) – Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
21. März bis 25. März 2018

Einladung

Den genauen Ablauf der Tagung ersehen Sie aus beiliegendem Programm. In Ausnahmefällen müssen wir uns Referentenwechsel und sonstige inhaltliche und organisatorische Änderungen vorbehalten.

Teilnahmegebühr und enthaltene Leistungen

Die Teilnahmegebühr beträgt je Teilnehmer 1350,00 Euro zzgl. MwSt. In der Gebühr enthalten sind Übernachtung mit Halbpension, Pausengetränke und Snacks, die eventuelle Teilnahme an begleitenden Veranstaltungen sowie Transfer vom Flughafen ins Hotel. Soweit verfügbar ist ebenfalls ein Gruppenflug von einem der festgelegten Flughäfen nach Mallorca und zurück enthalten, bzw. eine Pauschale in Höhe von 370,00 Euro zur Buchung eines Fluges über die Partnerfirma der Veranstalter ASYS Group. Zusätzliche Flugkosten werden über die Teilnahmegebühr hinaus in Rechnung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, sich möglichst frühzeitig anzumelden, um zusätzliche Flugkosten zu vermeiden. Rechtzeitig vor Reiseantritt erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen. Die Reiseunterlagen werden Ihnen zusammen mit einem Begleitschreiben von der Partnerfirma der Veranstalter ASYS Group, Benzstrasse 10, 89160 Dornstadt, Tel.: (07348) 9855-5107, E-Mail: nicole.egle@asys-group.com, Frau Nicole Egle, zugesendet.

Zahlung

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie über die Firma TBB eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung über die Teilnahmegebühr im Auftrag der Veranstalter. Die Teilnahmegebühr ist sofort und ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung fällig. Ihre Seminarteilnahme kann nur gewährleistet werden, wenn die Zahlung der Teilnahmegebühr vor Seminarbeginn eingegangen ist.

Rücktritt

Bei Stornierung der Anmeldung bis 22. Januar 2018 werden die halben Gebühren berechnet, bei Nichterscheinen oder verspäteter Abmeldung werden die vollen Gebühren berechnet. Selbstverständlich ist auch eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich, Umbuchungskosten müssen jedoch in Rechnung gestellt werden. Namensänderungen sind bei Flügen nicht möglich. Stornierungen sind grundsätzlich in schriftlicher Form einzureichen.

Haftungsausschluss

Die Firma TBB als Beauftragte der Veranstalter sowie die Veranstalter selbst übernehmen keine Haftung für Schäden und Verluste. Der Teilnehmer beteiligt sich auf eigene Gefahr an allen von ihm besuchten Veranstaltungen und trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung. Der Teilnehmer erklärt mit Abgabe seiner Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen gegen die Veranstalter sowie andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen einschließlich deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Veranstalter, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls haften die Veranstalter nicht für die Folgen höherer Gewalt. Dazu gehören Anordnungen von Behörden, Kriege, innere Unruhen, Flugzeugentführungen, Terroranschläge, Feuer, Überschwemmungen, Stromausfälle, Unfälle, Sturm, Streiks oder andere Arbeitskampfmaßnahmen, von denen die vermittelten Flüge oder Hotels sowie alle in die Veranstaltung integrierten Maßnahmen beeinflusst werden. Unbeschadet der Pflicht zur Leistungserbringung haften die Veranstalter jedenfalls nicht für Schäden, die aus einer eingetretenen Verzögerung der Leistungserbringung entstehen, insbesondere nicht, wenn die Verzögerung auf einer etwaigen Insolvenz Dritter, derer sich die Veranstalter zur Leistungserbringung bedienen, beruht.

Sonstige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass TBB ausschließlich namens und im Auftrag der einladenden Veranstalter handelt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie notwendige Auslandsversicherungen (Kranken-, Haftpflichtversicherung) abschließen. Ihre Anmeldeunterlagen werden zur Versendung der Reiseunterlagen an die Partnerfirma der Veranstalter ASYS Group sowie bei Umbuchungen an das Reisebüro Honold weitergegeben. Wir weisen auf die Anwesenheit der Presse hin. Im Ausnahmefall der Veranlassung eines verlängerten Aufenthaltes auf Wunsch des Teilnehmers handelt es sich um eine unentgeltliche Kulanzleistung, für die jede Haftung ausgeschlossen ist.

Anmeldung

Anmeldung möglichst bis 22. Januar 2018 schriftlich oder online an:

TBB Technologie Beratung Bell | Hadlichstr. 26 | D-13187 Berlin
Tel. (030) 4810363 | franziskabell@t-b-bell.de